(11)Publication number:

63-090534

(43)Date of publication of application: 21.04.1988

(51)Int.CI.

G03C **G03C** G03F

(21)Application number: 61-236129

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22) Date of filing:

06.10.1986

(72)Inventor: SUGIYAMA HISASHI

NATE KAZUO **INOUE TAKASHI** 

**MIZUSHIMA AKIKO** 

# (54) ALKALI-SOLUBLE LADDER SILICONE POLYMER

# (57)Abstract:

PURPOSE: To provide the titled polymer high in oxygen plasma resistance, capable of film formation using a conventional solvent, thus usable as a highly valuable photo- or radiationsensitive material, having ladder silicone skeleton as the main chain and phenolic hydroxyl group in the side chain.

CONSTITUTION: The objective alkali-soluble ladder silicone polymer of formula (R1-SiO312)n (R2-SiO312)m(R3-SiO312X)I [R1 is organic group having phenolic hydroxyl group R2 and R3 are each organic group free of phenolic hydroxyl group; n, m and I are each integer satisfying the relationship: n/(n+m+l)>0.4]. The R1, R2 and R3 are p-hydroxybenzyl group, p-methoxybenzyl group and p- trimethylsiloxybenzyl group, respectively.

# THIS PAGE BLANK (USPTO)

# ⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

# <sup>⑫</sup> 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-90534

⑤Int,CI,⁴ C 08 G 77/04	識別記号 N U A	庁内整理番号 6561-4J		<b>③公開</b>	昭和63年(198	38)4月21日
G 03 C 1/71 1/72	3 2 1	7267—2H 7267—2H				
G 03 F 7/10			審查請求	未請求	発明の数 1	(全5頁)

の発明の名称

アルカリ可溶性ラダーシリコーン重合体

②特 顋 昭61-236129

②出 類 昭61(1986)10月6日

砂発	明	者	杉	Щ		寿	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内	
⑦発	明	者	名	手	和	男	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作	
							所生産技術研究所内	
⑦発	明	者	井	上	隆	史	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作	
							所生産技術研究所内	
⑦発	明	者	水	島	明	子	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作	
							所生産技術研究所内	
⑦出	願	人	株式	会社	日立製作	所	東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地	
砂代	理	人	弁理	士(	ト川 勝	男	外1名	

月 網 有

1. 発明の名称

アルカリ可辞性ラダーシリコーン重合体

- 2. 特許請求の範囲
  - 1 下記一般式(1)で表わされるアルカリ可溶性ラ ダーシリコーン重合体。

 $(R_1-S10_{5/2})_a(R_2-S10_{5/2})_a(R_5-S10_{5/2})_{\ell}$  … (1) (ただし、一般式(1)中の $R_1$ はフェノール性水散 基を有する有根基、 $R_2$  および $R_5$ はフェノール性 水散基を含まない有根基である。また、 $n_1m_1\ell$  は整数で、 $\frac{n}{n+m+\ell}>0.4$  を満たさなければな 5 ない。)

- 2 上記一般式(1)中のR<sub>1</sub>がp-ヒドロキシベンジル基、R<sub>2</sub>がp-メトキシベンジル基、R<sub>3</sub>がp-トリメチルシロキシベンジル基であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のアルカリ可溶性ラダーシリコーン重合体。
- 5 発明の詳細な説明:

〔産業上の利用分野〕

本発明は、光かよび放射経感応性材料等の機能

性高分子材料として極めて有用な新規な重合体に 関する。さらに詳しくは、アルカリ可溶性ラダー シリコーン重合体に関する。

## 〔従来の技術〕

半導体素子や集積回路等の電子部品の製作には、 光むよび放射線を利用したエッチングによる敬細 加工技術が用いられ、現在、そのレジスト材料と しては、解像度に使れていることから、フェノー ル樹脂やポリピニルフェノールのようなアルカリ 可溶性重合体を基本重合体として含むアルカリ現 像形のレジスト材料が主流を占めている。たとえ は、ノポラック樹脂と 1、2-ナフトキノンジアジ ド類との組成物はポジ形フォトレジストであり、 ポリピニルフェノールとヒスアジド類との組成物 はネガ形フォトレジストにたる。また、ノポラッ ク樹脂とポリオレフィンスルホンとの組成物は放 射艇感応性ポジ形レジストであることは、広く知 られている。一方、半導体業子等の配線の微細化 に伴ない、レジスト暦をパターニングした後の下 地のエッチングは、従来の位式エッチングに代っ

# 特開昭63-90534 (2)

て、ドライエッチングが採用されつつある。

なか、アルカリ現像形レジストの文献としては、
J. C. Strieter 著:コゲック・マイクロエレクト
ロニクス・セミナー・プロシーディング( Kodak
Microelectronics Saminor Proceeding ) 116
(1976) 等が挙げられる。

#### (発明が解決しよりとする問題点)

上記したように、レジスト層バターニング後の下地エッチングにドライエッチングが採用されつつあり、とのためレジスト材料に対しては、ドライエッチングに対する強い耐性が要求されることになる。しかしたがら、従来のアルカリ現像形レジスト材料は、下地が金属や金属酸化腹等(たとえばアルミニウム、シリコン、シリコン酸化腹等)の場合に使用されるハログン系ブラズマには強い耐性を示すが、下地が有機物(たとえば二層レジスト法における下層平坦化腹やポリイミド等の層間絶線膜等)の場合に用いられる酸素ブラズマに対する耐性は充分ではなく、その特性向上が強く望まれていた。

ただし、一般式(i)中の $R_1$ はフェノール性水酸基を有する有機基、 $R_2$ および $R_2$ はフェノール性水酸基を含まない有機基である。また、n, m,  $\ell$ は整数であり、  $\frac{n}{n+m+\ell} > 0.4$ を満たさなければならない。

ことで、R1 は具体的には、たとえば、

等フェノールやカテコールを置換基として有する 炭素数 1~6(置換基の炭素を除く)のアルキル 基等が挙げられる。

一方、これ以外のラダーシリコーン骨格に付随 する側鎖R2 およびR5は、一個の有機基であれば飼 約はない。具体的に例を挙げれば、上述したフェ ノール性水酸基を有する有機基の水酸基をアルコ キシ茶。セーブチルジメチルシロキシ基あるいは そとで、本発明の目的は、上記した従来の酸素 プラズマ耐性の低いアルカリ現像形レジストの基 本重合体に代わる、酸素プラズマ耐性の優れたア ルカリ可溶性重合体を提供することにある。

[問題点を解決するための手段]

酸素プラズマ耐性の優れた重合体としては、有機ケイ素系重合体がよく知られている。これは、有機ケイ素系重合体が酸素プラズマにより効率よくケイ素酸化膜になり、このケイ素酸化膜が、酸素プラズマ耐性膜として働くためである。一方、アルカリ可溶性の重合体としては、ノボラック樹脂やボリビニルフェノールのようなフェノール性水酸基を有する重合体が知られている。

そこで上記目的を達成するために、主観がケイ 素酸化物の構造に敷も近いラダーシリコーン骨格 で倜縛にフェノール性水散塞を有する重合体を積 々合成した結果、下記一般式(1)で安わされるアル カリ可溶性ラダーシリコーン重合体がよいことが わかった。

 $(R_1-S1O_{3/2})_* (R_2-S1O_{3/2})_* (R_5-S1O_{3/2})_{\ell} \cdots (1)$ 

メチレンアセタール等の形で保護した基や、アル キル基,ビニル基等が挙げられる。

ただし、アルカリ可溶性にするためには、フェ ノール性水酸素を有する有機基が全体の側鎖の40 多以上存在しなければ充分なアルカリ可溶性は得 られない。

本発明の重合体は、初めに水酸基を保護した形のラダーシリコーン重合体を合成し、ついで保護基を保護したではずすことにより合成される。水酸基を保護した形のRiに対応したトリクロロシランは、社どの手法、たとえば、ハログン化物(塩化ペンジル誘導体を方ととができるのはステレンランやテンクリニャール反応、あるいはステレンが導体に使うとは、なの分解後、水酸化カリウムで等、種々の条件で行なうことができる。さらに、保護器をはず

# 特開昭63-90534 (3)

す場合にも、たとえば、アルコキン基から水酸基へはトリメテルシリルクロライドとヨウ化ナトリクムを用いる方法や、トリメテルシリルヨードを用いる方法等、また、モーブテルジメテルシロやン基からはテトラーローブチルアンモニウムフルオタイドを用いる方法、メチレンアセタールからは五塩化リンを用いる方法等、種々の反応を用いて行なうととができる。したがって、本発明の重合体を合成するにあたり、その合成法は限定されるものではない。

本発明の重合体はアルカリ性溶液に可溶である
一方、汎用有機溶剤、たとえばアルコール系、エ
ーテル系、アミド系、ケトン系、エステル系、セ
ロソルブ系等の有機溶剤にも容易に溶解し、これ
5の溶液を用いて成蹊することができる。

したがって、従来のアルカリ現像レジストと同様に本重合体を基本重合体とし、種々の感光性溶解阻害剤を選べば、本重合体はそれらに対応した光あるいは放射線用のレジスト材料にすることができる。

サン-co-p-トリメチルシロキシベンジルシルセスキオキサン)

- 1 p-メトキシベンジルトリクロロシランの合成 提择機、冷却管、演化ロートおよび塩酸トラ ップを備えた 5 ℓ 三ッロフラスコを選案置換す る。フラスコに、塩化第 1 鋼 7 9 g ( 1 80 mol )と トリーローブロピルアミン 1261 g ( 8 80 mol )を 入れ、p-メトキシベンジルクロライド 1256 g. (8 02mol)とトリクロロシラン 1184 g ( 8 7 4 mol ) の混合物を、温柔圧下撹拌しながら 5 時間かけ で施下する。フラスコ温度が富温に戻るまで熟 成した後、ヘキサン 1 ℓ を入れ、塩を析出させ る。塩を確遇した後、波圧蒸留することにより 目的物を 1182 g ( 4 62 mol ) 得た。収率 57.7 %; 沸点 92 ℃ / 4 mm Hg; NMR ( 60 MHz, CCℓ4, CH2 Cℓ2, 8 5.55), 8 2.95 (2H, e), 8 5.85 (3H, e), 8 & 86 (2H, d, J=9 Hg), 87.15 (2H, d, J=9 Hg)
- 2 ポリ(p-メトキシペンジルシルセスキオキ サン)の合成

撹拌機、冷却管、滴下ロートかよび塩酸トラ

一方、本発明の重合体の膜は酸素プラズマ中で全く膜はりせず、値めて高いドライエッチング耐性を示す。したがって、上記レジストは、下地の有機物を酸素プラズマによりドライエッチングする場合の酸素プラズマ耐性膜として働き、たと允は、二層レジスト法の上層レジスト等に使用することができる。

#### (作用)

本発明の重合体は、重合体骨格がケイ無酸化膜 の構造に最も近いラダーシリコーン骨格であるた めに、酸素プラズマ耐性が高く、また、側鎖にフェノール性水酸基を有する有機基が存在するため にアルカリ可溶性になったものと考えられる。

#### 〔寒施例〕

以下、本発明を実施例によって具体的に説明するが、本発明はとの実施例に限定されるものでは ない。

#### 実施例 1

ボリ(p-ヒドロキシベンジルシルセスキオキ サン-co-p-メトキシベンジルシルセスキオキ

ップを備えた 5ℓ三ッロフラスコに水 2ℓを入れる。トルエン 1ℓに搭解させた p - メト 中シベンジルトリクロロシラン 1182g(4.62mol)を 選拌したがら、1.5時間で滴下し、ついで 1.5時間 熱水する。 混合物を分液 n - トに移し、トルエン暦を分離する。トルエンと水を蒸留により除いた後、上記加水分解生成物に水酸化カリウムの10重量 f メタノール溶液 12gを入れ、200℃で 2時間 加熱する。 減圧加熱することにより、目的物を 797g(4.60mol) 得た。 収率 99.4 f; 数平均分子量 1000~100000; NNR(60Mf2, CDCℓ3, CH2Cℓ2, 85.55), 81.95(2H, br. 8), 85.85(5H, br. 8), 84.80(4H, br. 8); IR(v cm<sup>-1</sup>) 2940, 2850, 1620, 1520, 1470, 1305, 1260, 1190, 1150, 1040, 845

よ ボリ(p-ヒドロキシベンジルシルセスキオ キサン)の合成

提件機、冷却管、滴下ロートかよび塩取トラップを備えた 5 ℓ 三ッロフラスコを選業量換する。ポリ( p - メトキシペンジルシルセスキオ

特開昭63-90534 (4)

キサン) 797g (4.60mol)をアセトニトリル 600 ml に加熱溶解させてフラスコに入れ、ついで ョウ化ナトリウム 1378g (9.20mol)を加える。 **窒素圧下加熱環流しながら、トリメチルタロロ** シラン 999g(9, 20mol)を 4時間で積下する。 窒素圧下加熱遺流しながら18時間熟成した後、 水 200㎜をゆっくり滴下し、ついで、水とアセ トニトリルを加えて、さらに加熱遺流を6時間 行なう。アセトニトリル層を分離し、ついで、 アセトニトリル層を亜硫酸水果ナトリウムと食 塩の混合水溶液で洗い、水に筒下して再次する。 真空加熱により乾燥し、目的物を 368g(2 31 mol ) 得元。収率 50.2%; 数平均分子量1000~ 100000; NMR ( 60 MHz , DMS 0 - 46, CH2 Cl2, 8 5.68), 8 1.75(2H, br. m), 8 6.61(4H, br. s), 88.93(1H, br. s); IR(+cm-1) 3350, 1620, 1520, 1450, 1250, 1190, 1150, 1050, 845. 805. 760

4 ポリ(p-ヒドロキシベンジルシルセスキオ キサン-co-p-メトキシベンジルシルセスキ オキサン-co-p-トリメチルシロキシベンジ ルシルセスキオキサン ) の合成

5 項記載のポリ(p-ヒドロキシベンジルシルセスキオキサン)の合成法において、メトキシ基をトリメテルシロキシ基に変換する反応試案(トリメテルクロロシランとヨウ化ナトリウム)の量を減らすかあるいは熟成時間を短くすることにより、メトキシ基を任意の割合で残すことができる。また、トリメテルシロキシ基を加水分解により水酸基に変換する過程において、熟成時間を短くすると、トリメテルシロキシ基の約15多まではそのまま残すことができる。

表:に、熱成時間を変えた時のポリ(p-ヒドロキシベンジルシルセスキオキサン-co-p-メトキシベンジルシルセスキオキサン-co-p-トリメチルシロキシベンジルシルセスキオキサン)
におけるそれぞれの構成単位のモルチを示す。

#### 潜解性

本発明の重合体の溶解性に関して、代表的を汎 用有機溶剤で調べた結果、水酸基含有量40%以上

の本重合体は、メタノール、テトラヒドロフラン、N,N-ジメテルアセトアミド、2-メチルシクロヘキサノン、酢酸イソアミル、エチルセロソルブ、ジメテルスルホキシドには溶解したが、トルエン、ヘキサン、四塩化炭素には不善であった。一方、水溶液では、水酸化テトラメテルアンモニウム水溶液に溶解した。

#### 酸果プラズマ耐性

本発明の重合体の 8 重量 8 2 - メチルシクロへキサノン溶液を、シリコン基板上に、スピンコーティング法により盗布し、100℃で30分間ペークすることにより、0.2 μm 厚の盆膜を形成した。つづいて、酸素プラズマ(条件:02 圧 0.5 Torr, RF 300 m, パレル形アッシャー)に20分間さらしたが、本重合体は全く膜減りしなかった。

### (発明の効果)

本発明の重合体は、汎用有機器剤に可能である ので成膜することができ、また、アルカリ性水器 液にも溶解するので本重合体を基本重合体とした 種々の感光性溶解阻害剤あるいは感放射線性溶解

メトキシベンシルシルセスキオキサン-co-ロ-トリメチルシロキシベンジルシルセ スキオキサン)でおける構成単位のモルカ

**熟成時間を変えた時のポリ(p-mドロキシペンジルシルセスキオキサン-co-p-**

X

						-		$\overline{}$
	R₁Oモル≶	0	0	g 10	1 5	ю	1.5	1 5
	R₂O € № §	1.5	4	0.5	0	. 0	4.5	2.5
	R, O モル≶	8.5	96 .	66	8.5	9.7	0.7	9.0
HOOSINe	政策反応の党政時間/4	9	9	s:	G	4	0	0
-OveOSIVes	保護反応の表現時間~10	60	1.2	17	18	# 8	80	S
	į	-	2	×	•	2	9	7

特開昭63-90534 (5)

阻害剤との組成物は、それらに対応した光あるいは放射線用のレジスト材料として使用できる。一方、本重合体は酸素プラズマ耐性に優れているので、これらレジストを二層レジスト法の上層レジスト等に使用することができる。以上述べたように、本発明の重合体は、光および放射線感応性材料の機能性高分子材料として、極めて効用の大なるものである。

# THIS PAGE BLANK (USPTO)